香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ASMPT LIMITED

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：0522）

新聞稿

ASMPT完成戰略方案評估並保留SMT解決方案分部

題為《ASMPT完成戰略方案評估並保留SMT解決方案分部》的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
Bassel Haddad

香港，二零二六年十一月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：Bassel Haddad 先生及許一帆女士。

（本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。）

媒體專用

ASMPT完成戰略方案評估並保留SMT解決方案分部

人工智能基礎設施結構性需求增長支持SMT長期發展

（二零二六年十一月五日，新加坡訊） — ASMPT（香港交易所股份代號：0522），全球領先之半導體和電子產品製造的硬體及軟件解決方案供應商ASMPT宣布，其董事會已得出結論，保留SMT解決方案分部作為ASMPT集團的一部分符合本公司及其股東的最佳利益。 因此，二零二六年一月啟動的SMT解決方案分部戰略方案評估已結束。

董事會在全面審視一系列策略方案，包括出售、合資、分拆、上市，以及將業務保留於集團旗下後，認為SMT解決方案分部的增長及盈利前景，繼續作為ASMPT的一部分，將為創造可持續的長期股東價值的機會。

ASMPT集團行政總裁Bassel Haddad表示：「自我於八月加入ASMPT以來，我持續見證人工智能（AI）如何為ASMPT的業務組合帶來新的機遇。對於我們的SMT解決方案分部而言，AI帶動的需求正推動業務的財務表現邁向新的台階。隨著SMT在ASMPT內的未來發展方向進一步明確，我們將專注於嚴謹執行，充分實現其潛力，並為股東創造可持續的長期價值。」

更強勁的業務格局正在形成

SMT解決方案分部的業務格局正逐步超越週期性復甦階段。人工智能基礎設施正在服務器、網絡、光學及電源領域增添新的需求引擎，加上系統整合需求不斷增加，以及對靈活性、速度、檢測及工藝性能等更高價值能力的需求。

集團估計，在加速人工智能基礎設施投資的支持下，SMT目標市場將於二零二四年至二零二七年間以超過20%的複合年增長率擴張。 近期上調進一步擴大該目標市場，並為可持續長期增長創造更多機會。

保留SMT解決方案分部亦使ASMPT擴大於人工智能硬體價值鏈的參與度，並於ASMPT的產品組合中創造新的機會。集團的SEMI解決方案分部參與人工智能基礎設施所需的日益複雜的封裝，而SMT解決方案分部則支持人工智能伺服器、網絡及電源應用所需的系統級集成。

市場份額增長及更高價值的業務組合

儘管人工智能基礎設施推動對SMT解決方案分部的需求，但該需求質量同樣重要，這使該分部處於服務對靈活性、速度、檢測和工藝效能有更高要求的更複雜應用的有利位置。 SMT解決方案分部的產品越來越多地服務於該等高價值的應用。

SMT解決方案分部的新增訂單市場份額由二零二五年的約24%增長至二零二六年迄今的約31%，同期由約7億美元增長一倍多至14億美元以上。

SMT解決方案分部的訂單構成亦正出現重大變動。人工智能相關應用的訂單佔年初至今訂單的比例由二零二四年的12%上升至二零二六年的50%以上。此表明人工智能相關訂單份額於兩年間增加約四倍，並與人工智能基礎設施投資建立更直接的聯繫。

先進封裝正日益成為重要的增長支柱。SMT解決方案分部的先進封裝新增訂單總額於二零二六年年初至今大幅增至約3.40億美元，而其佔該分部訂單總額的份額則上升至約25%。

財務狀況的重大轉變

該等發展有望使SMT解決方案分部之財務狀況出現重大轉變，預計其銷售收入將由二零二五年的水平增長一倍，於二零二七年達約16億美元。於同期，其毛利率預計將由30%低段水平提升至約40%，而分部溢利率亦預計將大幅提升，至2027年達到20%。

該預期改善反映出，隨著SMT解決方案分部規模擴大及其業務組合轉向更高價值應用，將帶來顯著的經營槓桿及盈利上行空間。綜合而言，更廣泛的市場需求、更高質素之銷售收入，以及更有利的業務組合，正進一步鞏固SMT解決方案分部的增長、盈利能力及策略定位，惠及ASMPT及其股東。

關於ASMPT Limited

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬體及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號：0522)，並且是香港交易所科技100指數、恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。詳細資訊請查閱ASMPT網頁www.asmpt.com。

前瞻性聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明反映ASMPT根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻性聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，多種因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻性聲明，而ASMPT不會承擔任何義務公開地更新或修訂任何前瞻性聲明。除下文另有提及外，本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

新聞垂詢：

投資者關係
傅志泓 (Benjamin Poh)
投資者關係
b.poh@asmpt.com

ASMPT全球媒體辦公室

林詒源 (Lim Ee Guan)
企業傳訊總監
eg.lim@asmpt.com